

**中信证券股份有限公司**  
**关于中科寒武纪科技股份有限公司**  
**2025 年度持续督导跟踪报告**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”或“公司”或“上市公司”）非公开发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。

**一、持续督导工作概述**

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2026 年 3 月 20 日、3 月 23 日至 27 日对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、股东会及董事会议事规则等公司治理制度、股东会及董事会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2025 年度内部控制评价报告、2025 年度内部控制审计报告等文件；

（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2025 年度审计报告、关于中科寒武纪科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告；

(4) 查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；

(5) 对公司高级管理人员进行访谈；

(6) 对公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

## 二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

## 三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

### 1、核心竞争力风险

公司所处行业为技术密集型行业。公司掌握的核心技术及公司研发水平将直接影响公司的核心竞争力。公司是目前行业内少数全面系统掌握了智能芯片及其基础系统软件研发和产品化核心技术的企业之一，公司掌握的核心技术具有一定技术壁垒，关键核心技术处于行业的领先水平。但随着人工智能应用及算法的逐步普及，人工智能芯片受到了多家集成电路龙头企业的重视，该领域也成为多家初创集成电路设计公司发力的重点。此外，研发项目的进程及结果的不确定性较高，公司将面临前期的研发投入难以收回、预计效益难以达到的风险。未来，公司将不断贴近市场需求，提升研发投入效率，保障产品的快速迭代，以此保障公司提升自身的核心竞争力。

### 2、经营风险

(1) 供应链稳定风险

公司采用 Fabless 模式经营，供应商包括 IP 授权厂商、服务器厂商、晶圆制造厂和封装测试厂等。由于集成电路整个行业链是专业化分工且技术门槛较高，加之公司及部分子公司已被列入“实体清单”，将对公司供应链的稳定造成一定风险。切换新供应商将产生一定成本，将可能对公司经营业绩产生不利影响。

但公司的核心技术来自于寒武纪的自主研发，拥有自主知识产权，为应对上述风险，公司将基于产业政策与产业链上下游长期、广泛、良好的合作，在产品研发各阶段继续与各相关方保持良好沟通，并积极探索，做好各项应对工作，推动公司业务持续发展。

## （2）客户集中度较高的风险

近三年，公司前五大客户的销售金额合计占营业收入比例分别为 92.36%、94.63%和 88.66%，客户集中度较高。若公司主要客户经营发生变动或者需求放缓，可能给公司业绩带来不利影响。此外，公司面临着新客户拓展的业务开发压力，如果新客户拓展情况未达到预期，亦会对公司经营业绩造成一定不利影响。

公司将把握人工智能前沿发展路线，推动技术和产品的迭代优化，以适应更多商业客户对智能计算的差异化需求，同时抓住人工智能技术开始进入各行业领域的战略机遇期，加大市场拓展力度，服务更多的人工智能客户群体。

## 3、财务风险

### （1）研发投入相关的财务风险

公司一直保持着较高的研发投入，报告期内公司研发投入为 116,910.10 万元，占报告期内营业收入的比例为 17.99%。为保持技术先进性和市场竞争力，公司将持续保持高强度的研发投入，可能将对公司的经营成果产生一定影响。

### （2）大额股份支付的风险

为进一步建立、健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，公司持续实施股权激励计划。报告期内，公司发生股份支付费用 23,872.55 万元，公司前期实施且处于等待期的限制性股票在未来几年将持续摊销。同时，若未来公司发布实施新股权激励计

划，将可能持续产生大额股份支付费用。

### （3）毛利率波动风险

报告期内，公司的综合毛利率，一方面受产品组合、公司拓展新业务、产品售价、原材料及封装测试成本、生产工艺水平等多种因素的影响；另一方面，受所在行业的影响，芯片行业的综合毛利将与国家政策调整、市场竞争程度、全球供应链稳定等情况高度相关。若前述因素发生变动，公司毛利率可能存在一定波动，进而影响经营成果和业绩表现。

### （4）存货跌价风险

公司根据客户订单需求以及对市场未来需求的预测情况制定采购计划，截至本期期末，存货账面价值为 494,353.25 万元，占期末资产总额的比例为 36.79%。若未来市场环境发生变化可能导致公司存货跌价风险增加，对公司的盈利能力产生不利影响。

## 4、行业风险

近年来，随着人工智能应用及算法的逐步普及，人工智能芯片受到了多家集成电路龙头企业的重视，该领域也成为多家初创集成电路设计公司发力的重点。总体来看，人工智能芯片技术仍处于发展阶段，技术迭代速度较快，技术发展路径尚在探索中，尚未形成具有绝对优势的架构和系统生态。随着越来越多的厂商推出人工智能芯片产品，该领域市场竞争日趋激烈。目前，英伟达在全球人工智能芯片领域中仍占有绝对优势。

未来，公司将把握人工智能前沿发展路线，推动技术和产品的迭代优化，以适应更多商业客户对智能计算的差异化需求，同时抓住人工智能技术开始进入各行业领域的战略机遇期，加大市场拓展力度，以应对行业风险。

近年来，国内半导体行业原材料需求持续增长，采购价格整体呈上涨态势。若未来上游原材料价格持续走高，将可能对公司经营业绩产生不利影响。公司将通过战略备货、产品迭代等方式积极应对上游原材料价格上涨压力。

## 四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

## 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	649,719.62	117,446.44	453.21
归属于上市公司股东的净利润	205,922.85	-45,233.88	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,993.42	-86,495.15	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-49,839.81	-161,796.02	不适用
主要会计数据	2025 年末	2024 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,183,617.40	542,265.87	118.27
总资产	1,343,771.41	671,781.25	100.03
主要财务指标	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	4.93	-1.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	4.88	-1.09	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	4.23	-2.08	不适用
加权平均净资产收益率(%)	26.96	-8.18	增加35.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	23.17	-15.64	增加38.81个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	17.99	91.30	减少73.31个百分点

1、本期营业收入较上年同期增加 532,273.18 万元，同比增长 453.21%，主要系受益于人工智能行业算力需求的持续攀升，公司凭借产品的优异竞争力持续拓展市场，积极推动人工智能应用场景落地，报告期内营业收入较上年同期大幅增长。

2、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损

益的净利润均实现扭亏为盈，主要系本期营业收入大幅增长所致。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 111,956.21 万元，主要系本期销售回款较上年同期增加所致。

4、归属于上市公司股东的净资产、总资产较上年末分别增长 118.27%、100.03%，主要系本期收入规模大幅增长带动利润增长及公司 2025 年度向特定对象发行新股募集资金所致。

5、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率，本期由负转正，主要系本期归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现扭亏为盈所致。

6、公司保持了较高强度的研发投入，研发投入较上年同期增长 9.03%，研发投入占营业收入的比例为 17.99%。但由于本期营业收入增长幅度远高于研发投入增长幅度，因此研发投入占营业收入的比例较上年同期减少 73.31 个百分点。

## 六、核心竞争力的变化情况

### （一）公司的核心竞争力

#### 1、领先的核心技术优势

寒武纪是智能芯片领域全球知名的新兴公司，能提供云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。公司掌握的智能处理器指令集、智能处理器微架构、智能芯片编程语言、智能芯片数学库等核心技术，具有壁垒高、研发难、应用广等特点，对集成电路行业与人工智能产业具有重要的技术价值、经济价值和生态价值。

公司在智能芯片及相关领域开展了体系化的知识产权布局，为公司研发的核心技术保驾护航。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计申请的专利为 2,846 项。按照专利地域可分为：境内专利申请 1,831 项，境外专利申请 705 项，PCT 专利申请 310 项；按照专利类型可分为：发明专利申请 2,767 项，实用新型专利申请 42 项，外观设计专利申请 37 项。

公司累计已获授权的专利为 1,734 项。按照专利地域可分为：境内专利 1,203 项，境外专利 531 项；按照类型可分为：发明专利 1,661 项，实用新型专利 37 项，外观设计专利 36 项。

此外，公司拥有软件著作权 65 项；集成电路布图设计 6 项。

## **2、人才团队优势**

公司董事长、总经理陈天石博士曾在中科院计算所担任研究员（正高级职称）、博士生导师，在人工智能和处理器芯片等相关领域从事基础科研工作近二十年，积累了坚实的理论功底和丰富的研发经验，创办并领导公司跻身全球智能芯片公司前列。

公司在技术研发、供应链、产品销售等方面均建立了成熟团队，核心骨干均有多年从业经验。公司核心研发人员多毕业于著名高校或科研院所，拥有计算机、微电子等相关专业的学历背景，多名骨干成员拥有知名半导体公司多年的工作经历。公司员工中有 80.13% 为研发人员，80.95% 的研发人员拥有硕士及以上学位，研发队伍结构合理、技能全面，有力支撑了公司的技术创新和产品研发。

## **3、产品体系优势**

目前，公司已推出的产品体系覆盖了云端、边缘端的智能芯片及板卡、智能整机、处理器 IP 及软件，可满足云、边、端不同规模的人工智能计算需求。公司的智能芯片和处理器产品可高效支持大模型训练及推理、视觉（图像和视频的智能处理）、语音处理（语音识别与合成）、自然语言处理以及推荐系统等多样化的人工智能任务，高效支持视觉、语音和自然语言处理等多模态人工智能任务，可辐射智能制造、智能教育、智慧金融、智能家居、智慧医疗、智慧互联网等“智能+”产业。

## **4、客户资源优势**

公司凭借领先的研发能力、可靠的产品质量和优秀的客户服务水平，积累了良好的品牌认知和优质的客户资源。目前公司产品广泛服务于大模型算法公司、服务器厂商、人工智能应用公司，辐射云计算、能源、教育、金融、电信、医疗、互联网等行业的智能化升级，支撑人工智能行业快速发展。借助运营积累的客户

基础，公司进一步提升了品牌认可度和市场影响力，上述优质客户的品牌效应也有助于公司进一步开拓其他客户的合作机会。同时，丰富的现有客户资源也为公司新产品的市场开拓提供了便利，可以实现多类产品的销售协同，为公司的业务拓展和收入增长打下了良好的基础。

## 5、品牌优势

随着公司近年来的快速发展，成功推出了多款智能芯片及处理器 IP 产品。公司已建立起健全的质量管理体系，并通过了 ISO9001 质量管理体系认证。公司凭借领先的产品性能、可靠的产品质量以及周到的技术支持，在市场中赢得了良好的口碑，不断巩固并提升公司在业界的知名度和影响力。

公司成立至今共获得多项荣誉：2017 年 12 月，公司获得全球知名创投研究机构 CB Insights 颁布的“2018 年全球人工智能企业 100 强”奖项；2018 年 11 月，于深圳举办的第二十届中国国际高新技术成果交易会上，寒武纪 1M 处理器、思元 100 智能芯片、思元 100 加速卡三款产品连续斩获高交会组委会颁发的“优秀创新产品奖”；同月，公司上榜由美国著名权威半导体杂志《EETimes》评选的“2018 年全球 60 家最值得关注的半导体公司（EETimes Silicon 60 of 2018）”榜单；2019 年 6 月，公司入选《福布斯》杂志中文版颁布的“2019 福布斯中国最具创新力企业榜”；2019 年 10 月，思元 270 芯片获得第六届乌镇世界互联网大会“世界互联网领先科技成果奖”；2020 年 4 月，公司获得全球知名创投研究机构 CB Insights 颁布的“2020 IC DESIGN China”奖项；2020 年 6 月，公司获得胡润研究院“2020 胡润中国芯片设计 10 强民营企业”荣誉称号；2020 年 6 月，公司上榜《EETimes》评选的“2020 年全球 100 家最值得关注的半导体公司（EETimes Silicon 100）”榜单；2021 年 3 月，公司上榜《EETimes》评选的“AI 芯片公司(AI CHIP) TOP 10”榜单；2021 年 7 月，公司的思元 290 智能芯片及加速卡、玄思 1000 智能加速器获得了由世界人工智能大会组委会颁发的“SAIL 之星”奖；2025 年 1 月，公司获得胡润研究院“2024 胡润中国人工智能企业 50 强”荣誉称号并位居榜首；2025 年 3 月，公司获得全球电子工程领域权威技术媒体机构 AspenCore 颁布的“2025 年度中国 IC 设计成就奖”奖项；2025 年 5 月，公司入选福布斯中国颁布的“2025 福布斯中国人工智能科技企业 TOP50”

榜单；2025年11月，公司入选福布斯中国颁布的“2025福布斯中国创新力企业50强”榜单。

## （二）核心竞争力变化情况

持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

## 七、研发支出变化及研发进展

### （一）研发支出变化

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	116,910.10	107,231.44	9.03
资本化研发投入	-	-	/
研发投入合计	116,910.10	107,231.44	9.03
研发投入总额占营业收入比例（%）	17.99	91.30	减少 73.31 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	/

注：本表中“研发投入”不包含股份支付费用

公司保持了较高强度的研发投入，研发投入较上年同期增长 9.03%，研发投入占营业收入的比例为 17.99%。但由于本期营业收入增长幅度远高于研发投入增长幅度，因此研发投入占营业收入的比例较上年同期减少 73.31 个百分点。

### （二）研发进展

报告期内，公司在研项目的研发进展如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	云端智能芯片	不适用	61,697.99	288,763.25	迭代研发中	面向云端等数据中心场景，研发具有充裕算力、充裕的内存容量和带宽的人工智能芯片，芯片适用于大模型等多样化的人工智能训练和推理任务	国际先进水平	可应用于智能计算中心、互联网等领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
2	基础系统软件	不适用	35,715.76	250,427.77	迭代研发中	为人工智能各类任务提供高效、灵活的应用开发平台，在不同场景下达到优异的性能；支持业界主流人工智能编程框架，提供完备的开发、调试、性能调优工具链	行业先进水平	可应用于大模型、智能视觉、智能语音、自然语言理解、搜索推荐等领域
3	硬件平台	不适用	19,209.98	63,007.71	迭代研发中	基于公司的人工智能芯片，研发适用于各种场景的硬件产品，兼容业界主流服务器板卡接口，提供不同的产品形态适用于不同的人工智能算力场景需求	国际先进水平	可应用于智能计算中心、互联网等领域
合计	/	/	<b>116,623.72</b>	<b>602,198.74</b>	/	/	/	/

注：本表中“本期投入金额”不包含研发人员对应的股份支付费用

#### 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

#### 九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，募集资金进度与原计划基本一致，基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。

#### 十、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持

## 情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况如下：

单位：股

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	质押或冻结情况
陈天石	董事长、总经理、核心技术人员	2019 年 11 月	2028 年 11 月	119,530,650	119,530,650	0	/	无
金晓光	董事	2024 年 8 月	2028 年 11 月	0	0	0	/	无
刘新宇	董事	2022 年 11 月	2028 年 11 月	0	0	0	/	无
刘少礼	董事、副总经理、核心技术人员	2019 年 11 月	2028 年 11 月	16,000	16,000	0	/	无
王在	董事、副总经理	2019 年 11 月	2028 年 11 月	16,000	16,000	0	/	无
叶湔尹	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	2019 年 11 月	2028 年 11 月	31,392	31,392	0	/	无
胡燊翀	独立董事	2022 年 11 月	2028 年 11 月	0	0	0	/	无
李寿双	独立董事	2025 年 11 月	2028 年 11 月	0	0	0	/	无
刘思义	独立董事	2025 年 11 月	2028 年 11 月	0	0	0	/	无
陈帅	副总经理、核心技术人员	2022 年 11 月	2028 年 11 月	0	0	0	/	无
刘毅	副总经理、核心技术人员	2022 年 11 月	2028 年 11 月	4,000	4,000	0	/	无
张尧	副总经理、核心技术人员	2022 年 11 月	2028 年 11 月	2,399	2,399	0	/	无
吕红兵	独立董事（届满离任）	2019 年 11 月	2025 年 11 月	0	0	0	/	无
王秀丽	独立董事（届满离任）	2019 年 11 月	2025 年 11 月	0	0	0	/	无
<b>合计</b>	/	/	/	<b>119,600,441</b>	<b>119,600,441</b>	<b>0</b>	/	/

除上述情况外，公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在其他质押、冻结及减持情况。

#### 十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中科寒武纪科技股份有限公司  
2025 年度持续督导跟踪报告》之签署页)

保荐代表人：

彭捷

彭捷

侯理想

侯理想

